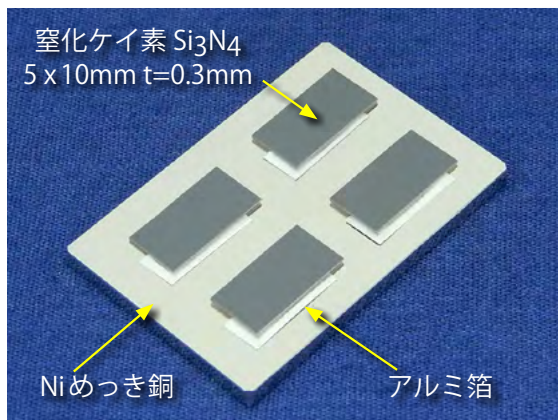




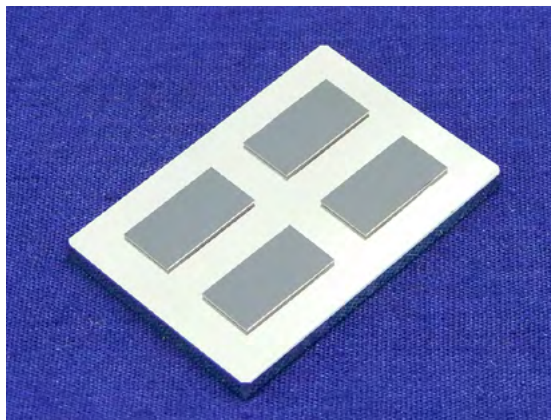
SoundBonding application



〈セラミックス基板とヒートシンクの
ダメージのない異材料間一括接合〉 Patent pending



接合前



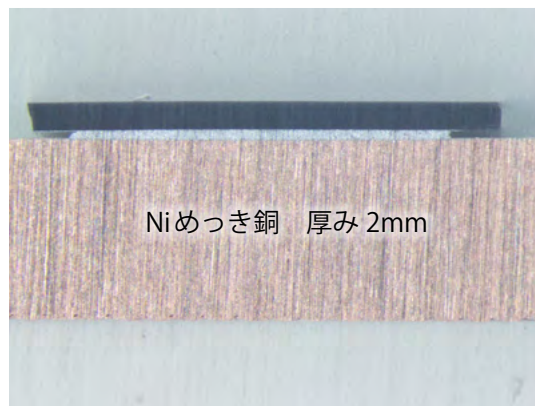
接合後



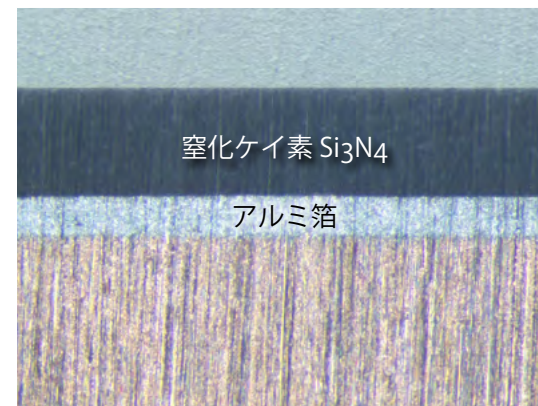
折り曲げて接合強度を確認



- ★窒化ケイ素基板とNiめっき銅製ヒートシンク
の間にアルミシートを挟んだ異材料間接合
- ★4個のセラミックス基板を一括同時接合
- ★ヒートショックテストクリア (-50 ~ 600°C)
- ★音エネルギーのみで接合
- ★大気中常温接合
- ★接合のエネルギー源は電気とエア
- ★デスクトップ接合



接合断面観察



接合部拡大

SoundPower[®]
Laboratory

ULTEX[®]



SoundBonding application

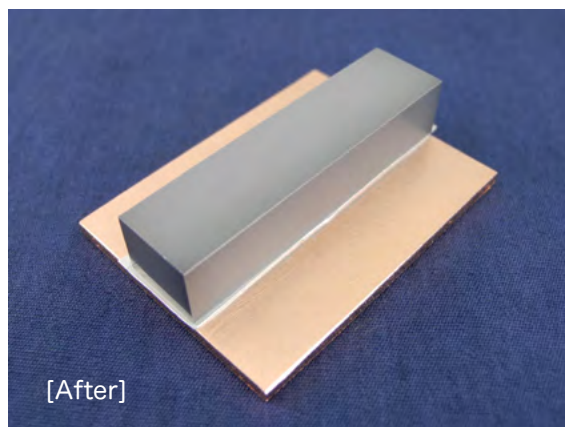
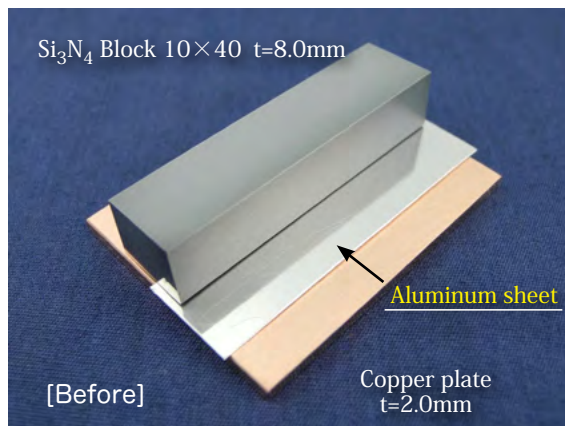


〈アルミを挟んだセラミックスの異材質間音波接合〉

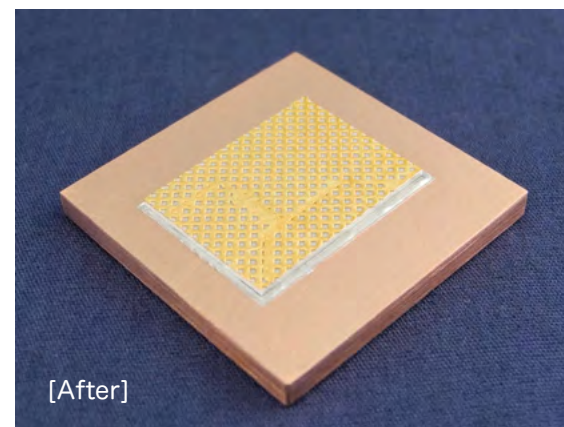
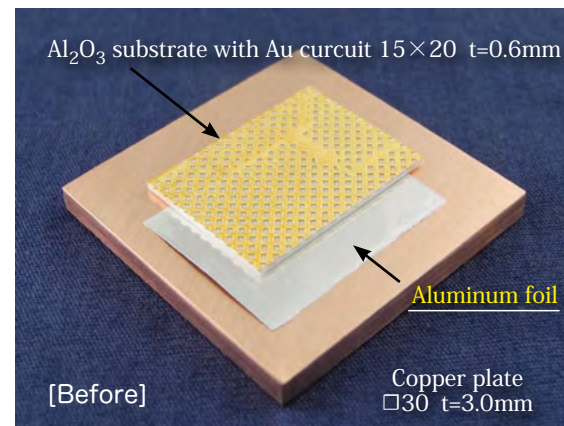
大気中・常温・窒化ケイ素・アルミナ基板・銅板



15/20MZi Lab system



★ [窒化ケイ素 & 銅板]



★ [アルミナ基板 & 銅板]